

#### 特点:

频率范围: 20~150MHz

功率增益: 典型值 29dB

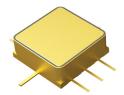
噪声系数: 典型值 2.5dB

输出-1dB 压缩点: 典型值+21dBm

SMD 封装

尺寸: 9.2×9.2×3.7mm(不含引脚)

## 图片:

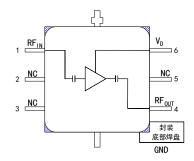




#### 性能参数: (50Ω系统, T<sub>A</sub>=-55℃~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			* *	Ø 34±
			MIN	TYP	MAX	单位	备注
频率范围	f	$V_D$ =+15V f=20 $\sim$ 150MHz $P_{IN}$ =-30dBm	20		150	MHz	
功率增益	G		28	29	30	dB	
增益平坦度	ΔG			0.6	1.0	dB	
输入驻波	VSWR <sub>I</sub>			1.6:1	2.0:1		
输出驻波	VSWRo			1.6:1	2.0:1		
噪声系数	NF			2.5	3.0	dB	
方向隔离度	IR		33			dB	
输出-1dB 压缩点	OP-1dB	$V_D$ =+15.0V, f=20~150MHz	+20	+21		dBm	
电源电压	$V_D$		+14.5	+15.0	+15.5	V	功能正常
工作电流	$I_D$	$V_D = +15.0V$ , $P_{IN} = -30 dBm$		60	70	mA	
质量	m				2	g	

#### 功能框图:







### 引脚定义:

引脚编号	符号	描述	
1	$RF_{IN}$	射频输入端口,AC 耦合	
4	RF <sub>OUT</sub>	射频输出端口,AC 耦合	
6	$V_{\mathrm{D}}$	电源供电端口	
2/3/5	NC	悬空	
底部中央焊盘	GND	接地	

#### 极限参数表:

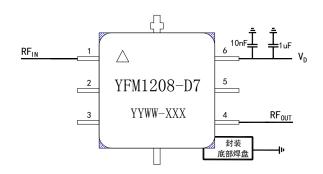
参数名称	极限值			
输入射频功率	+7dBm			
电源电压	0∼+17V			
装配温度	+230℃, 20s			
工作温度	-55∼+85℃			
贮存温度	-55∼+125°C			
静电放电敏感度等级	1A			

超过以上任何一项极限参数,可能造成器件永久损坏。

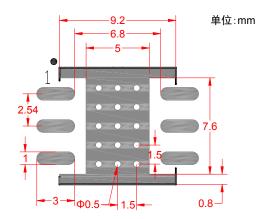




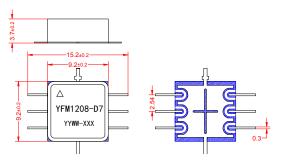
#### 推荐应用电路:



#### 推荐焊盘图:



#### 外形尺寸图:



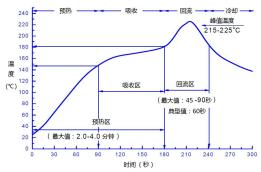
- 注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T 1804-m;
  - 2、产品采用气密陶瓷封装,引脚表面镀镍金(Ni:1.3~8.9um, Au:1.3~5.7um);
  - 3、产品标识采用激光刻字。

#### 字符标志:

3 13 13 13 13 15						
标识	说明	备注				
YFM1208-D7	产品型号					
Δ	1 脚&静电敏感标识					
YYWW	批次号					
XXX	序列号					

#### 产品使用注意事项:

- 1. 产品属于静电敏感器件,产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
- 2. 产品使用时请保证接地良好(GND引脚和底部金属化区域)。
- 3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用,采用 Sn63/Pb37 锡膏,熔点+183℃回流焊接,回流温度推荐曲线。





# YFM1208-D7

#### 20~150MHz 集成宽带放大器

12210-0189V0 (

此图为推荐回流温度曲线,因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线,实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

- 4. 如特殊情况需采用手工补焊,烙铁温度+350℃,焊接时间不超过3秒;回流及手工焊接次数不大于3次。
- 5. 产品属于磁性敏感器件,产品在运输、储存过程中应注意远离磁场环境,产品设计应用时应考虑强磁环境对该器件的磁性影响。
- 6. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装,存放条件:温度+10~+35℃,湿度 35~65%RH;对于需长期储存(超过半年)产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 7. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境,客户在对产品焊接及清洗完成后,应对产品进行三防喷涂处理,以提高产品耐环境适应性能力。